Si-IGBT プロセスによる FZ-Si の少数キャリアライフタイムへの影響評価

Evaluation of Minority Carrier Lifetime in FZ-Si Affected by Si-IGBT Process

^o小林 弘人¹, 横川 凌^{1,2}, 鈴木 貴博¹, 沼沢 陽一郎¹, 小椋 厚志¹, 西澤 伸一³
更屋 拓哉⁴, 伊藤 和夫⁴, 高倉 俊彦⁴, 鈴木 慎一⁴, 福井 宗利⁴, 竹内 潔⁴, 平本 俊郎⁴
(1. 明治大理工, 2. 学振特別研究員 DC, 3. 九州大工, 4. 東京大工)

^oH. Kobayashi¹, R. Yokogawa^{1,2}, T. Suziki1¹, Y. Numasawa, A. Ogura¹ and S. Nishizawa³

T. Saraya⁴, K. Ito⁴, T. Takakura⁴, S. Suzuki⁴, M. Fukui⁴, K. Takeuchi⁴, T. Hiramoto⁴

(1. Meiji Univ., 2. JSPS Research Fellow DC, 3. Kyushu Univ., 4. Tokyo Univ.) E-mail: ce171027@meiji.ac.jp

【背景・目的】Si 絶縁ゲートバイポーラトラ ンジスタ(Si-IGBT)は高耐圧パワー半導体デバ イスとして現在の主流であり、今後の更なる高 性能化実現にはキャリアライフタイム制御が 必要不可欠である[1]。しかし、Si-IGBT プロセ スによるライフタイム劣化のメカニズムは未 解明であり、これまでの研究ではデバイス構造 全体の平均・マクロな評価のみが行われている。 本研究ではトレンチゲート形成およびゲート 絶縁膜作製プロセスに着目し、PL イメージン グと光導電率減衰測定によりライフタイムを 多角的に評価し、ライフタイム劣化要因の特定 を試みた。

【実験方法】 Table 1 に本実験で使用した試 料の作製条件を示す。FZ-Si ウェーハ上に dry 酸化(1050℃, 17分, O2雰囲気)および wet 酸化 (900℃, 12 分, H₂O 雰囲気)の 2 条件で同じ膜厚 (約 35 nm)の酸化膜を形成した。また、トレン チ形成後に上記 2 条件でゲート酸化を行った 試料も用意し、各々の試料で比較を行った。測 定は酸化膜除去前後のライフタイムを Sinton 社 WCT-120 を用いて行った。酸化膜除去後の ライフタイム測定では表面をキンヒドロンメ タノールでパッシベーションした。またフォト ルミネッセンス(PL)法(励起波長: 808 nm, 検 出側のフィルター: Band Pass Filter(1140 ± 90 nm)) により、試料断面(TEG)の顕微イメージン グ測定を行った。

【実験結果】 Fig.1に酸化膜除去前後のライ フタイム測定結果を示す。購入品(As-grown)の ライフタイム(約 2 msec)はプロセスによって 劣化し dry 酸化>トレンチ+dry 酸化>wet 酸化> トレンチ+wet 酸化の順に高いライフタイムを 示した。一方酸化膜除去後には、ライフタイム はほぼ完全に回復している。Fig.2に Sample C の断面 PL イメージング像を示す。PL 強度よ り試料表面側でバルク内部に比べてライフタ イムが低くなっていることが確認された。これ らの結果から、ゲート酸化後のライフタイム劣 化は、バルク欠陥などによるものではなく、酸 化膜界面におけるキャリア再結合が大きく影 響し、界面特性が wet 酸化に比べて dry 酸化が 優れていることが確認された。

以上、トレンチ形成およびゲート絶縁膜プロセ スとライフタイムに相関があることが明らか になり、本研究結果は次世代 Si-IGBT 作製プロ セス最適化に寄与する結果と考える。

【謝辞】 本研究の一部は新エネルギー・産業 技術総合開発機構の支援のもと実施された。

【参考文献】

[1] N. Iwamoto *et al.*, IEEE Trans. Electron Devices, **64**, 741 (2017).

Table 1 Sample fabrication process



Fig. 1. Lifetime before and after oxide film removal



Fig. 2. Cross-section micro-PL image of sample C (TEG)